

2025 年度通期決算説明会（2026 年 4 月 28 日開催）

QA 要旨

Q1. 今年度（2026 年度）の製品粗利率は、昨年度（2025 年度）を若干下回る水準の見込みとのことですが、上期、下期で見ると、上期は改善が見られるが、下期は新規量産品の立上げの影響で悪化する見通しでしょうか。

A1. 今年度は、説明の通り、通期では昨年度の水準（31.4%）を若干下回ると見ていますが、四半期では、製品構成により多少のバラつきは見られると思います。

Q2. 今年度の通期予想について、為替レートが\$1=130 円前提ですが、なぜ実勢レートとは大きく乖離した為替前提を採用しているのでしょうか。

A2. 当社のビジネスは外貨比率がかなり高く、また調達金額も大半が外貨になってきていることから、為替変動による業績への影響が大きくなる傾向にあります。そのため保守的かもしれませんが、このような為替前提を採用しています。尚、併せて為替感応度も示しています。また、商談獲得から設計・開発、量産までのライフサイクルが長いので、長期のビジネスを一貫して見るためには同じレートで、会社全体でもプロジェクト毎の採算を見ていく必要があります。その際はやはり保守的なレートで一貫して見る必要があると考えています。

Q3. 今年度の通期予想について、足元では中国での EV 需要の減速や、メモリ製品の不足による生産への影響など、最終需要への影響が出ているのではないかと思います。貴社のビジネスにも影響が出ていますか。

A3. まず、中国の EV 需要の影響については、EV 全体の需要の状況と個社の状況は少し異なるのではないかと思います。当社が昨年度半ばより量産立上げ、供給を開始したお客様は、市場の状況で需要の増減はあるものの、今年度は通年で供給していくので昨年度から増加します。また、北米向けにも新規量産が始まるので、自動車向けの売上は拡大していく見込みです。

次に、メモリ製品の需給がタイトになることによる影響について、調達量や価格面で影響を受けているお客様は多いと思いますが、状況はお客様によって異なると見ています。当社で DRAM 等の調達をするケースも若干ありますが、基本的にはお客様と協力し、先行的に必要な量の確保に努めるとともに、DRAM を切り替える場合の技術的評価等のサポートも行っています。一定のリスクは見通しに織り込んでいるつもりですが、今後もその影響を注視していきたいと思っています。

Q4. 今年度の商談獲得金額の目標を教えてください。

A4. 今年度の商談獲得金額については、少なくとも昨年度と同等の金額は獲得したいと考えていますが、それを上回る水準を目指しています。今年度はデータセンター/ネットワーク分野、自動車分野向けをバランスよく獲得したいと考えています。

Q5. Medium-Term Targets について、昨年度の実績から見ると目標値と大きく乖離していますが、達成できるのでしょうか。

A5. 売上高については、2025 年度後半から拡大に向かい、本目標策定時（2025 年 4 月）の想定を上回る成長を期待しています。営業利益については、2025 年度実績及び 2026 年度予想ともに、製品粗利率が本目標策定時の想定を下回り、営業利益額、営業利益率ともに策定時の想定を下回っています。来年度（2027 年度）以降も、製品粗利率は策定時の想定を下回りますが、売上高の拡大がこれをオフセットし、営業利益額が増加していくこと、また、そのレバレッジ効果による営業利益率の改善に期待しています。

Q6. 2024 年度に獲得したデータセンター/ネットワーク向けの製品や 2025 年度に量産開始した自動車向けの製品が、他のお客様やアプリケーションへも販売できる可能性はあるのでしょうか。

A6. データセンター向けの CPU については、最終サンプルの評価の段階から量産プロセスの準備に入っており、今年度順調に量産が立ち上がれば、データセンター向け CPU の需要も拡大傾向なので、いわゆる横展開の可能性もあると考えています。昨年度量産立上げの車載向け製品については、車載以外のアプリケーションへの活用の話もありますが、現時点で具体的には確認していません。

Q7. CPU の事業機会について、貴社は大手 IP ベンダーのサポーターパートナーとしても名前が挙がっていますが、今後も事業の拡大が期待できるのでしょうか。

A7. 当社は、IP ベンダーとは緊密で良好な関係を築いています。IP ベンダーも今後、IP ビジネスのみならず、彼らのエコシステムを活用した製品の提供や、チップそのものを開発、提供するビジネスも拡大していくとしています。当社はどのビジネスモデルでも協力関係を活かせると考えています。最先端のデータセンター向け SoC では、性能、消費電力、コストの目標を満たすために、Compute、Memory、I/O をチップレットとして構成する設計が採用されています。当社は IP ベンダーのエコシステムでの豊富な経験に加え、Memory および I/O チップレット実装における独自の Flexlets を発表しています。当社は、このパートナー関係を、技術力の向上、そして事業拡大に繋げていきたいと考えています。

以上